



平成 24 年 1 月 23 日

各 位

会 社 名	サ ン 電 子 株 式 会 社
代 表 者 名	代表取締役社長 吉田 喜春 (JASDAQ コード:6736)
問 合 せ 先	取締役経理担当 加藤 俊朗
電 話 番 号	(0587) 55-2201

連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ

当社は、平成24年1月23日開催の当社取締役会において、平成24年4月1日を効力発生日として、当社の100%連結子会社である株式会社ブルーム・テクノを吸収合併することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は100%子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

株式会社ブルーム・テクノは、電子・電気部品及び製品の開発・製造・販売を主たる業務としており、アミューズメント機器用グラフィックチップ開発の分野における仕様策定、基板設計や品質管理において高い技術水準を有しております。

この度、当社グループの経営資源の集中と経営の効率化を図るべく、同社を吸収合併することといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

合併決議取締役会	平成24年1月23日
合併契約締結	平成24年2月6日(予定)
合併効力発生日	平成24年4月1日(予定)

注) 本合併は、当社において会社法第796条第3項に定める簡易合併であり、株式会社ブルーム・テクノにおいて同法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも株主総会の承認を得ることなく行うものであります。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ブルーム・テクノは解散いたします。

(3) 合併に係る割り当ての内容

該当事項はありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要(平成23年9月30日現在)

(1) 商号	サン電子株式会社 (存続会社)	株式会社ブルーム・テクノ (消滅会社)
(2) 事業内容	電子機器の開発・製造・販売	電子・電気部品及び製品の開発・製造・販売
(3) 設立年月日	昭和 46 年 4 月 16 日	平成 17 年 1 月 6 日
(4) 本店所在地	愛知県江南市古知野町朝日 250 番地	横浜市港北区新横浜三丁目 17 番 6 号 イノテックビル 9 階
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田 喜春	代表取締役社長 伊藤 清
(6) 資本金の額	891 百万円	300 百万円
(7) 発行済株式総数	10,353,066 株	6,000 株
(8) 事業年度の末日	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	東海エンジニアリング(株) 19.7% 前田昌美 5.1% 従業員持株会 4.4% 前田英行 3.4% 内海倫江 3.1% 渡辺恭江 3.1%	サン電子(株) 100.0%
(10) 直前事業年度(平成23年 3 月 31 日)の財政状態及び経営成績		
純資産	10,040百万円 (連結)	636百万円 (単体)
総資産	15,707百万円 (連結)	1,106百万円 (単体)
1 株当たり純資産	932.16円 (連結)	184,341.46円 (単体)
売上高	13,702百万円 (連結)	1,844百万円 (単体)
営業利益	220百万円 (連結)	103百万円 (単体)
経常利益	233百万円 (連結)	104百万円 (単体)
当期純利益	141百万円 (連結)	34百万円 (単体)
1 株当たり当期純利益	13.44円 (連結)	5,759.77円 (単体)

4. 合併後の状況

本合併による当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金の額及び決算期の変更は、ありません。

5. 今後の見通し

本合併は、100%子会社との合併であるため、連結業績への影響は軽微であります。

以 上